

檔 號：
保存年限：

行政院國家科學委員會 函

地址：台北市和平東路2段106號
聯絡人：潘敏治 助理研究員
電話：02-2737-7983
傳真：02-2737-7673
電子信箱：mcpan@nsc.gov.tw

受文者：慈濟大學

發文日期：中華民國99年9月1日

發文字號：臺會工字第0990063554號

速別：普通件

密等及解密條件或保密期限：普通

附件：如說明四（099D2018557.DOC）（099D2018557.DOC，共1個電子檔案）

主旨：本會工程處推動之『晶片系統國家型科技計畫-技術深耕專案計畫』，自即日起接受申請，至99年9月30日截止，逾期恕不受理，請查照轉知。

說明：

- 一、本專案主持人須為已執行過NSoC計畫2年(含)以上之計畫主持人。
- 二、本專案研究型別為整合型計畫，但是計畫主持人需彙整所有內容成一本計畫書，且不再分總計畫與各子計畫。
- 三、計畫申請作業，請依國科會補助專題研究計畫辦法，研提正式計畫申請書(採線上申請)，自即日起接受申請，並由計畫主持人所任職之機構於99年9月30日前備函送達本會(請彙整造冊後專案函送)，逾期恕不受理。
- 四、本專案相關徵求計畫書說明(如附件)及詳細內容業已公佈於網站(國科會工程處網站<http://www.nsc.gov.tw/eng/>)-最新消息。

正本：國立臺灣大學等284個單位

副本：本會綜合處、工程處

99/09/02
08:39:38

主委公出陳正宏副主委代行戳